

Übersicht Warengliederung

1	Materialien	4	Inspektions- und Testsysteme
2	Herstellungsverfahren und -technik	5	Bauelemente/Geräte
3	Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration	6	Anwendungen
		7	Dienstleistungen und Services

Warengliederung

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | Materialien | 2.2 | Digitale Druckverfahren |
| 1.1 | Substrate | <input type="checkbox"/> 2.2.1 | Inkjetdruck |
| <input type="checkbox"/> 1.1.1 | Plastikfolien | <input type="checkbox"/> 2.2.2 | Sonstige digitale Druckverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.1.2 | Metallfolien | 2.3 | Sonstige Druckverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.1.3 | Papier | <input type="checkbox"/> 2.3.1 | Mikrokontaktdruck |
| <input type="checkbox"/> 1.1.4 | Glas | <input type="checkbox"/> 2.3.2 | Nano imprint |
| <input type="checkbox"/> 1.1.5 | Textilien | 2.4 | Vakuumprozesse |
| <input type="checkbox"/> 1.1.6 | Sonstige Substrate | <input type="checkbox"/> 2.4.1 | Aufdampfverfahren |
| 1.2 | Leitende Materialien | <input type="checkbox"/> 2.4.2 | Sputtering |
| <input type="checkbox"/> 1.2.1 | Organische Leiter | <input type="checkbox"/> 2.4.3 | Organic vapor phase deposition (OVPD) |
| <input type="checkbox"/> 1.2.2 | Anorganische Leiter | <input type="checkbox"/> 2.4.4 | Sonstige Vakuumprozesse |
| <input type="checkbox"/> 1.2.3 | Nanomaterialien | <input type="checkbox"/> 2.5 | Fotolithografie |
| <input type="checkbox"/> 1.2.4 | Carbon Nanotubes | 2.6 | Laserverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.2.5 | Graphen | <input type="checkbox"/> 2.6.1 | Laserablation |
| <input type="checkbox"/> 1.2.6 | Hybride Leiter | <input type="checkbox"/> 2.6.2 | Lasertransfer |
| 1.3 | Halbleiter | 2.7 | Beschichtungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.3.1 | Polymere Halbleiter | <input type="checkbox"/> 2.7.1 | Rotationsbeschichtung (Spin coating) |
| <input type="checkbox"/> 1.3.2 | Halbleiter (kleine Moleküle) | <input type="checkbox"/> 2.7.2 | Tauchbeschichtung (Dip coating) |
| <input type="checkbox"/> 1.3.3 | Anorganische Halbleiter | <input type="checkbox"/> 2.7.3 | Rakelbeschichtung (Blade coating) |
| <input type="checkbox"/> 1.3.4 | Nanohalbleiter | <input type="checkbox"/> 2.7.4 | Sonstige Beschichtungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.3.5 | Carbon Nanotubes (Halbleiter) | 2.8 | Materialverarbeitung |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6 | Hybride Halbleiter | <input type="checkbox"/> 2.8.1 | Dispergiertechnik |
| 1.4 | Dielektrika | <input type="checkbox"/> 2.8.2 | Sonstige Materialverarbeitung |
| <input type="checkbox"/> 1.4.1 | Organische Dielektrika | 2.9 | Photoinduzierte Prozessierung |
| <input type="checkbox"/> 1.4.2 | Anorganische Dielektrika | <input type="checkbox"/> 2.9.1 | IR Trocknungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.4.3 | Nanomaterialien | <input type="checkbox"/> 2.9.2 | UV Verfahren |
| <input type="checkbox"/> 1.4.4 | Hybride Dielektrika | <input type="checkbox"/> 2.9.3 | Laserverfahren |
| 1.5 | Verkapselungsmaterialien und Kleber | 2.10 | Dosier- und Mischtechnik |
| <input type="checkbox"/> 1.5.1 | Dünnschichtverkapselung | <input type="checkbox"/> 2.10.1 | Pumpen |
| <input type="checkbox"/> 1.5.2 | Polymerverkapselung | <input type="checkbox"/> 2.10.2 | Sonstige Dosier- und Mischtechniken |
| <input type="checkbox"/> 1.5.3 | Metallverkapselung | 2.11 | Verkapselungstechnik |
| <input type="checkbox"/> 1.5.4 | Glasverkapselung | <input type="checkbox"/> 2.11.1 | Dünnschichtverkapselung |
| <input type="checkbox"/> 1.5.5 | Kleber | <input type="checkbox"/> 2.11.2 | Polymerverkapselung |
| <input type="checkbox"/> 1.6 | Sonstige Materialien | <input type="checkbox"/> 2.11.3 | Metallverkapselung |
| | | <input type="checkbox"/> 2.11.4 | Glasverkapselung |
| | | <input type="checkbox"/> 2.11.5 | Sonstige Verkapselungstechniken |
| 2 | Herstellungsverfahren und -technik | <input type="checkbox"/> 2.12 | Reinraumtechnik |
| 2.1 | Massendruckverfahren | <input type="checkbox"/> 2.13 | Rolle-zu-Rolle-Verfahren |
| <input type="checkbox"/> 2.1.1 | Tiefdruck | <input type="checkbox"/> 2.14 | Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken |
| <input type="checkbox"/> 2.1.2 | Offsetdruck | | |
| <input type="checkbox"/> 2.1.3 | Flexodruck | | |
| <input type="checkbox"/> 2.1.4 | Siebdruck | | |
| <input type="checkbox"/> 2.1.5 | Sonstige Massendruckverfahren | | |

Warengliederung

info@lopec.com, Tel. +49 89 949-20225

Messe München GmbH, Am Messesee 2, 81829 München, Deutschland

3 Elektronikfertigung, Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration

- 3.1 Elektrische Verbindungstechnik
 - 3.1.1 Flip Chip
 - 3.1.2 Sonstige Verbindungstechniken
- 3.2 Laminierung
- 3.3 Systemintegration
- 3.4 Hybride Systeme (Polytronik)

4 Inspektions- und Testsysteme

- 4.1 Elektrische Charakterisierung
- 4.2 Physikalische/Optische Charakterisierung
- 4.3 Chemische Charakterisierung
- 4.4 Simulation/Schaltkreisoptimierung
- 4.5 Lebensdauertest
- 4.6 Qualitäts-/Prozesskontrolle
- 4.7 Umweltprüfverfahren
- 4.8 Sonstige Inspektions- und Testsysteme

5 Bauelemente/Geräte

- 5.1 Transistoren
- 5.2 Dioden
- 5.3 Passive Bauelemente
 - 5.3.1 Kondensatoren
 - 5.3.2 Widerstände
 - 5.3.3 Sonstige passive Bauelemente
- 5.4 Integrierte Schaltkreise
- 5.5 Displays
 - 5.5.1 OLED
 - 5.5.2 Elektrophoretische Displays
 - 5.5.3 Elektrochrome Displays
 - 5.5.4 Elektrolumineszenz-Displays
 - 5.5.5 LCD
 - 5.5.6 Electrowetting
 - 5.5.7 Sonstige Displays
- 5.6 Photovoltaikzellen
 - 5.6.1 Organische Photovoltaikzellen
 - 5.6.2 Hybride Photovoltaikzellen
 - 5.6.3 Anorganische Photovoltaikzellen

5.7 Sensoren

- 5.7.1 Fotodioden
- 5.7.2 Drucksensoren
- 5.7.3 Temperatursensoren
- 5.7.4 Biomedizinische Sensoren
- 5.7.5 Gassensoren
- 5.7.6 Berührungssensoren
- 5.7.7 Sonstige Sensoren
- 5.8 Speicherbausteine
- 5.9 Antennen
- 5.10 Batterien
- 5.11 Komponenten für hybride Systeme
- 5.12 Sonstige Bauelemente

6 Anwendungen

- 6.1 TFT Backplanes
- 6.2 Displays
- 6.3 Sensoren
- 6.4 Intelligente Systeme
- 6.5 RFID
- 6.6 Solarzellen
- 6.7 Intelligente Textilien
- 6.8 Lautsprecher
- 6.9 Beleuchtung
- 6.10 Sonstige Anwendungen

7 Dienstleistungen und Services

- 7.1 Consulting
- 7.2 F&E Förderprogrammmanagement
- 7.3 F&E/Forschung & Entwicklung
- 7.4 Prototypenentwicklung
- 7.5 Auftragsfertigung
- 7.6 Kapital- und Risikobeteiligungsformen
- 7.7 Fachvereinigungen und -verbände
- 7.8 Fachbücher, Fachzeitschriften, Fachverlage
- 7.9 Sonstige Dienstleistungen